

## 微細な切削加工に適し、寸法安定性に優れる

セミトロン® MP370は、高温下での高い剛性と耐衝撃性を高めた変性PEEKをベース原料に、ファインセラミックを充てんした高機能材料です。

### 特長

- ・ガラス転移点が約160℃と、一般的なPEEK樹脂(同約143℃)より高いため、高温環境下でも高い剛性を保持する
- ・切削時のバリの発生が少なく、精度の高い加工が容易である
- ・吸水率が低く熱膨張率も小さいため、経年や環境温度の変化に伴う寸法変化を小さく抑えられる

### 用途例

#### ●半導体テスト工程

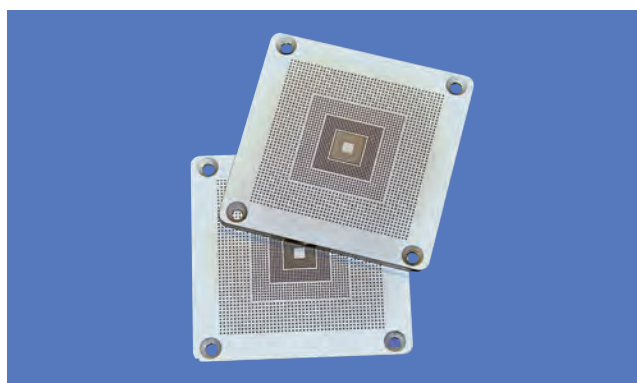
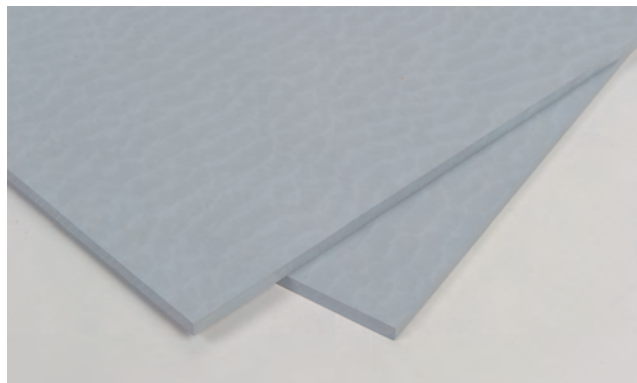
ソケット、ハンドリング治具

#### ●電子部品の検査治具

その他絶縁性が必要な精密機能部品

#### ⚠ 注意

ノッチ感度が高いので、設計にあたってはコーナ一部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。



加工例(ソケット)

### 性能比較

#### 高温特性

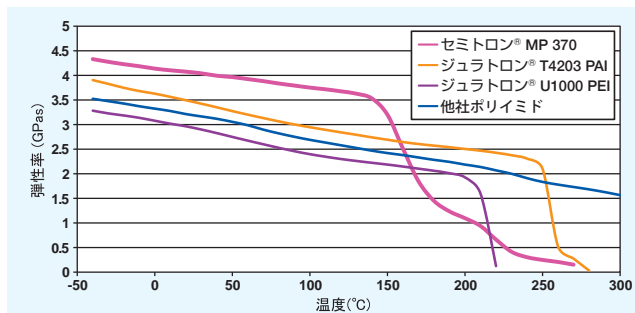


図5 動的粘弾性比較

各種耐熱素材の温度と剛性の関係を上図に示します。ICチップの検査工程で想定される150℃前後の温度領域において、セミトロン® MP370は高い弾性率を保持します。

### 切削加工精度

各種材料で同一条件の穴加工を行った際の穴位置の精度を右図に示します。

セミトロン® MP370は、ばらつきが少ないことが分かります。

〈加工条件〉■ 穴径: φ0.2 ■ ピッチ: 0.25mm  
■ 穴長さ: 2mm ■ 穴数: 100個

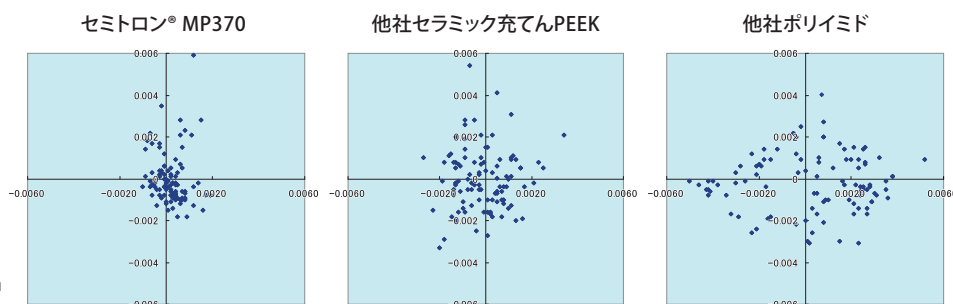


図6 切削加工精度比較